



**IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (IECQ)**  
covering Electronic Components,  
Assemblies, Related Materials and Processes  
For rules and details of the IECQ visit [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## IECQ Certificate of Conformity Manufacturer

|                       |                                              |             |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| IECQ Certificate No.: | IECQ-P JQAJP 13.0006                         | Issue No.:  | 5          | Status:    | Current    |
| Supersedes:           | <a href="#">IECQ-P JQAJP 13.0006 Issue 4</a> | Issue Date: | 2018/12/11 | Org Issue: | 2003/12/04 |
| CB Reference No.:     | JQAQ0008-001-M                               | Expiration: | 2021/12/25 |            |            |

### MIZUSAWA SEMICONDUCTOR CO., LTD

2-37 Mizusawa Kougyo Danchi, Oshu-city  
Iwate 023-0002  
Japan

The organization has developed and implemented procedures and related processes which have been assessed by the IECQ Certification Body issuing this certificate and found to comply with the applicable requirements of the IECQ Approved Process Scheme which is in accordance with the Basic Rules IECQ 01 "Rules of Procedure", IECQ 03-1 "IECQ General Requirements for all Schemes" & IECQ 03-2 "IECQ Approved Process Scheme" of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ), and in respect of standard(s) or specification(s):

- For a complete list of standards and specifications see the attached schedule of scope.

Process Manual Reference: M00-QS-000-01

Scope of Activity:

The manufacture and test of Semiconductor devices and Integrated circuits.

— Attached Schedule: IECQ-P JQAJP 13.0006\_S5.pdf —

**Issued by the Certification Body: Japan Quality Assurance Organization (JQA)**

c/o Safety & EMC Center,  
4-4-4 Minami-Osawa, Hachioji-shi,  
Tokyo 192-0364  
Japan

Authorized person:  
**Shigeyuki KONDO**



The validity of this certificate is maintained through on-going surveillance audits by the IECQ CB issuing this certificate.

This Certificate of Conformity may be suspended or withdrawn in accordance with the Rules of Procedure of the IECQ System and its Schemes.

This certificate and any schedule(s) may only be reproduced in full.

This certificate is not transferable and remains the property of the issuing IECQ CB.

The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



**IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (IECQ)**  
covering Electronic Components,  
Assemblies, Related Materials and Processes  
For rules and details of the IECQ visit [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## **Schedule of Scope to Certificate of Conformity Approved Process**

**IECQ Certificate No.: IECQ-P JQAJP 13.0006**

**CB Certificate No.: JQAQ 0008-001-M**

**Schedule Number: IECQ-P JQAJP 13.0006-S**

**Rev No.:5**

**Revision Date:2018/12/11**

**Page 1 of 1**

In respect of standards and specifications:

IEC 60747-1:2006

Semiconductor devices - Part 1: General

IEC 60748-1:2002

Semiconductor devices - Integrated circuits - Part 1: General

ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements

**Component:**

Semiconductor devices and Integrated circuits

**Scope:**

The purchase, manufacture and test of Semiconductor devices and  
Integrated circuits.

This schedule is only valid in conjunction with the referenced Certificate of Approval  
This approval and any schedule(s) may only be reproduced in full.  
This approval is not transferable and remains the property of the issuing body.  
The Status and authenticity of this approval and any schedule(s) may be verified by visiting the  
Official IECQ Website. [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

**Japan Quality Assurance Organization (JQA)**  
4-4-4, Minamiosawa, Hachioji-shi, Tokyo 192-0364 Japan





IEC 電子部品品質認証制度(IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## IECQ適合証明書 プロセス認証 製造事業者

|               |                             |       |            |        |            |
|---------------|-----------------------------|-------|------------|--------|------------|
| IECQ 証明書番号:   | IECQ-P JQAJP 13.0006        | 発行番号: | 5          | 認証状況:  | 継続中        |
| 旧 IECQ 証明書番号: | IECQ-P JQAJP 13.0006<br>第4版 | 発行日:  | 2018/12/11 | 初回発行日: | 2003/12/04 |
| CB 管理番号:      | JQAQ0008-001-M              | 有効期限: | 2021/12/25 |        |            |

### 株式会社 ミズサワセミコンダクタ

〒023-0002 岩手県奥州市水沢工業団地二丁目37番地

当該組織が開発し、実施する手順及び関連する工程は、この認証書を発行したIECQ認証機関による審査の結果、IECQプロセス認証スキームの要求事項に適合することを確認しました。審査は、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-2「IECQプロセス認証スキーム」及び以下の規格または仕様書に基づいています。:

- 認証対象部品仕様書は添付 附属書を参照
- ISO9001:2015 : 品質マネジメントシステム - 要求事項

参照プロセスマニュアル: M00-QS-000-01

認証範囲:

個別半導体デバイス、集積回路の製造、試験

詳細は添付附属書参照

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4

部門長: 近藤 繁幸



**JQA**

後援会員団体



Japanese Industrial Standards Committee

日本工業標準調査会

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 附属書

# プロセス認証 適合証明書の範囲の詳細

IECQ 証明書番号: IECQ-P JQAJP 13.0006

CB管理番号: JQAQ 0008-001-M

別添番号: IECQ-P JQAJP 13.0006-S

改訂番号:5

改訂日: 2018/12/11

ページ 1/1

## 仕様書及び規格

IEC 60747-1:2006

半導体素子 — 第 1 部: 一般

IEC 60748-1:2002

半導体素子 — 集積回路 — 第 1 部: 一般

ISO 9001:2015

品質マネジメントシステム — 要求事項

## 部品

個別半導体デバイス及び集積回路

## 適用範囲

個別半導体デバイス及び集積回路の製造、試験

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。  
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。  
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。  
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトで確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4